

Держатель Кремниевой Пластины Из Птфэ Для Кислотного Травления И Процессов Очистки 2 4 6 8 Дюймов, Настраиваемый, Устойчивый К Высоким Температурам

Артикул: PL-CP158



введение

Держатели кремниевых пластин из высокочистого ПТФЭ, разработанные для экстремальных процессов кислотного травления и очистки. Оптимизированные для пластин размером от 2 до 8 дюймов, эти прочные настраиваемые кассеты обеспечивают бесконтаминационную обработку и термостабильность в самых требовательных условиях производства полупроводников для закупок B2B.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Травление полупроводников	Перемещение пластин в концентрированных растворах HF или BOE (буферный окислительный травитель) для удаления диэлектрических слоев.	Исключительная устойчивость к агрессивным кислотам обеспечивает долговечность кассеты.
Процессы очистки RCA	Использование растворов SC-1 и SC-2 при высоких температурах для удаления органических и металлических загрязнений.	Высокая термостабильность предотвращает деформацию во время высокотемпературных окислительных ванн.
Производство фотоэлектрических элементов	Текстурирование и очистка кремниевых пластин при производстве высокоэффективных солнечных батарей.	Прочная конструкция обеспечивает высокопроизводительный промышленный поток с постоянной надежностью.
Производство МЭМС	Надежное удержание подложек в процессе сложного глубокого реактивно-ионного травления и мокрых процессов высвобождения.	Точно обработанные пазы защищают хрупкие микромеханические структуры от контактных повреждений.
Очистка травителем «Пирани»	Обработка пластин в смеси серной кислоты и перекиси водорода для удаления тяжелых органических веществ.	Материалы устойчивы к сильным окислительным атакам, предотвращая деградацию оборудования.
Исследования в нанотехнологиях	Специализированное перемещение нестандартных подложек при экспериментальном химическом осаждении из паровой фазы или обработке в жидкой фазе.	Полная настройка позволяет поддерживать нестандартные размеры пластин и уникальную геометрию.
Сборка оптоэлектроники	Очистка сапфировых или GaAs пластин перед эпитаксиальным наращиванием или нанесением тонких пленок.	Чистота материала ПТФЭ устраняет риск вмешательства следов металлов в оптических устройствах.

Категория спецификации	Детали параметров для PL-CP158	Доступность / Опции
Серия моделей	Кассета для кремниевых пластин PL-CP158	Стандартные и индивидуальные конструкции
Основной материал	Высокочистый ПТФЭ (политетрафторэтилен)	Опции PFA доступны по запросу
Совместимые размеры пластин	2 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов	Полностью настраиваемый под любой диаметр
Конфигурация пазов	Емкость и шаг определяются для каждого проекта	Настраивается по спецификации пользователя
Температурный диапазон	Эксплуатация от криогенных уровней до 260°C	Настройка в зависимости от процесса

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Категория спецификации	Детали параметров для PL-CP158	Доступность / Опции
Химическая стойкость	Полный спектр кислот, оснований и растворителей	Универсальная химическая совместимость
Метод изготовления	Точная обработка на 5-осевом ЧПУ	Индивидуальная геометрия доступна
Функции слива	Настраиваемые нижние / боковые порты слива	Оптимизировано для конкретных скоростей потока ванны
Конструкция ручки	Съемные или встроенные ручные / роботизированные ручки	Настраивается для совместимости с инструментом
Класс чистоты	Анализ следов и полупроводниковый класс	Сертифицированные высокочистые материалы